

2021-2027年中国芯片设计 产业发展现状与行业竞争对手分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国芯片设计产业发展现状与行业竞争对手分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202109/237016.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

我国芯片设计产业迅猛发展，年均增速在20以上，2017年我国芯片设计行业收入达2073.5亿元。2011-2017年我国芯片设计行业收入走势 中企顾问网发布的《2021-2027年中国芯片设计产业发展现状与行业竞争对手分析报告》共十七章。首先介绍了中国芯片设计行业市场发展环境、芯片设计整体运行态势等，接着分析了中国芯片设计行业市场运行的现状，然后介绍了芯片设计市场竞争格局。随后，报告对芯片设计做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国芯片设计行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片设计产业有个系统的了解或者想投资中国芯片设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分发展现状与前景分析

第一章全球芯片设计行业发展分析

第一节全球芯片设计行业基本特点

一、市场繁荣带动产业加速发展

二、企业重组呈现强强联合趋势

第二节全球芯片设计行业结构分析

一、2019年全球芯片设计行业产业规模

二、2019年全球芯片设计行业产业结构

第三节主要国家和地区发展分析

一、2019年美国芯片设计行业发展分析

二、2019年日本芯片设计行业发展分析

三、2019年中国台湾芯片设计行业发展分析

四、2019年印度芯片设计行业发展分析

第四节世界芯片设计行业发展现状分析

一、2019年世界芯片设计行业发展规模分析

二、2019年世界芯片设计行业发展特点分析

三、2019年世界芯片设计行业竞争格局分析

四、2019年世界芯片设计行业发展形势分析

第二章我国芯片设计所属行业发展现状

第一节中国芯片设计行业现状

- 一、行业规模不断扩大
- 二、行业质量稳步提高
- 三、产品结构极大丰富
- 四、原材料与生产设备配套问题

第二节芯片设计行业发展特点

- 一、产业持续快速发展
- 二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇
- 三、模拟ic和电源管理芯片成为国内ic设计热门产品

第三节2013-2019年芯片设计行业发展分析

一、2013-2019年芯片设计行业经济指标分析2017年我国芯片设计行业主要企业收入（单位：万元）

- 二、2013-2019年芯片设计业进出口贸易分析
- 三、2013-2019年行业盈利能力与成长性分析
- 四、2013-2019年芯片设计行业发展规模分析
- 五、2013-2019年芯片设计行业发展特点分析

第四节中国芯片设计业存在的主要问题分析

- 一、企业规模问题分析
- 二、产业链问题分析
- 三、资金问题分析
- 四、人才问题分析
- 五、发展的建议与措施

第三章中国芯片设计所属市场运行分析

第一节2019年中国芯片设计市场发展分析

- 一、2019年中国芯片设计市场消费规模分析
- 二、2019年主要行业对芯片的需求统计分析
- 三、2019年中国芯片设计市场消费规模分析
- 四、2019年主要行业对芯片的需求分析预测

第二节2019年中国芯片制造市场生产状况分析

- 一、2019年芯片的产量分析
- 二、2019年芯片的产能分析
- 三、2019年产品生产结构分析
- 四、2019年芯片的产量分析
- 五、2019年芯片的产能分析

第四章芯片设计产品细分市场分析

第一节2019年中国芯片细分市场发展趋势分析

- 一、生物芯片
- 二、通信芯片
- 三、显示芯片
- 四、数字电视芯片
- 五、标签芯片

第二节电子芯片市场

- 一、电子芯片市场结构
- 二、电子芯片市场特点
- 三、2019年电子芯片市场规模
- 四、2019年电子芯片市场分析
- 五、2021-2027年电子芯片市场预测

第三节通讯芯片市场

- 一、通讯芯片市场结构
- 二、通讯芯片市场特点
- 三、2019年通讯芯片市场规模
- 四、2019年通讯芯片市场分析
- 五、2021-2027年通讯芯片市场预测

第四节汽车芯片市场

- 一、汽车芯片市场结构
- 二、汽车芯片市场特点
- 三、2019年汽车芯片市场规模
- 四、2019年汽车芯片市场分析
- 五、2021-2027年汽车芯片市场预测

第五节手机芯片市场

- 一、手机芯片市场结构
 - 二、手机芯片市场特点
 - 三、2019年手机芯片市场规模
 - 四、2019年手机芯片市场分析
 - 五、2021-2027年手机芯片市场预测
- 第六节电视芯片市场
- 一、电视芯片市场结构
 - 二、电视芯片市场特点
 - 三、2019年电视芯片市场规模
 - 四、2019年电视芯片市场分析
 - 五、2021-2027年电视芯片市场预测

第五章中国芯片设计行业区域市场分析

第一节2019年华北地区芯片设计行业分析

- 一、2013-2019年行业发展现状分析
- 二、2013-2019年市场规模情况分析
- 三、2013-2019年市场需求情况分析
- 四、2021-2027年行业发展前景预测
- 五、2021-2027年行业投资风险预测

第二节2019年东北地区芯片设计行业分析

- 一、2013-2019年行业发展现状分析
- 二、2013-2019年市场规模情况分析
- 三、2013-2019年市场需求情况分析
- 四、2021-2027年行业发展前景预测
- 五、2021-2027年行业投资风险预测

第三节2019年华东地区芯片设计行业分析

- 一、2013-2019年行业发展现状分析
- 二、2013-2019年市场规模情况分析
- 三、2013-2019年市场需求情况分析
- 四、2021-2027年行业发展前景预测
- 五、2021-2027年行业投资风险预测

第四节2019年华南地区芯片设计行业分析

- 一、2013-2019年行业发展现状分析
 - 二、2013-2019年市场规模情况分析
 - 三、2013-2019年市场需求情况分析
 - 四、2021-2027年行业发展前景预测
 - 五、2021-2027年行业投资风险预测
- 第五节2019年华中地区芯片设计行业分析
- 一、2013-2019年行业发展现状分析
 - 二、2013-2019年市场规模情况分析
 - 三、2013-2019年市场需求情况分析
 - 四、2021-2027年行业发展前景预测
 - 五、2021-2027年行业投资风险预测
- 第六节2019年西南地区芯片设计行业分析
- 一、2013-2019年行业发展现状分析
 - 二、2013-2019年市场规模情况分析
 - 三、2013-2019年市场需求情况分析
 - 四、2021-2027年行业发展前景预测
 - 五、2021-2027年行业投资风险预测
- 第七节2019年西北地区芯片设计行业分析
- 一、2013-2019年行业发展现状分析
 - 二、2013-2019年市场规模情况分析
 - 三、2013-2019年市场需求情况分析
 - 四、2021-2027年行业发展前景预测
 - 五、2021-2027年行业投资风险预测

第六章芯片设计行业投资与发展前景分析

第一节2019年芯片设计行业投资情况分析

- 一、2019年总体投资结构
- 二、2019年投资规模情况
- 三、2019年投资增速情况
- 四、2019年分行业投资分析
- 五、2019年分地区投资分析

第二节芯片设计行业投资机会分析

- 一、芯片设计投资项目分析
- 二、可以投资的芯片设计模式
- 三、2019年芯片设计投资机会
- 四、2019年芯片设计细分行业投资机会
- 五、2019年芯片设计投资新方向
- 第三节芯片设计行业发展前景分析
 - 一、芯片设计市场发展前景分析
 - 二、我国芯片设计市场蕴藏的商机
 - 三、贸易战下芯片设计市场的发展前景
 - 四、2019年芯片设计市场面临的发展商机
 - 五、2021-2027年芯片设计市场面临的发展商机

第二部分市场竞争格局与形势

第七章芯片设计行业竞争格局分析

第一节芯片设计行业集中度分析

- 一、芯片设计市场集中度分析
- 二、芯片设计企业集中度分析
- 三、芯片设计区域集中度分析

第二节芯片设计行业主要企业竞争力分析

- 一、重点企业资产总计对比分析
- 二、重点企业从业人员对比分析
- 三、重点企业全年营业收入对比分析
- 四、重点企业利润总额对比分析
- 五、重点企业综合竞争力对比分析

第三节芯片设计行业竞争格局分析

- 一、2019年芯片设计行业竞争分析
- 二、2019年中外芯片设计产品竞争分析
- 三、2013-2019年国内外芯片设计竞争分析
- 四、2013-2019年我国芯片设计市场竞争分析
- 五、2013-2019年我国芯片设计市场集中度分析
- 六、2021-2027年国内主要芯片设计企业动向

第八章2021-2027年中国芯片设计行业发展形势分析

第一节芯片设计行业发展概况

- 一、芯片设计行业发展特点分析
- 二、芯片设计行业投资现状分析
- 三、芯片设计行业总产值分析
- 四、芯片设计行业技术发展分析

第二节2013-2019年芯片设计行业市场情况分析

- 一、芯片设计行业市场发展分析
- 二、芯片设计市场存在的问题
- 三、芯片设计市场规模分析

第三节2013-2019年芯片设计产销状况分析

- 一、芯片设计产量分析
- 二、芯片设计产能分析
- 三、芯片设计市场需求状况分析

第四节产品发展趋势预测

- 一、产品发展新动态
- 二、技术新动态
- 三、产品发展趋势预测

第三部分赢利水平与企业分析

第九章中国芯片设计行业整体运行指标分析

第一节2019年中国芯片设计行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业生产规模分析

第二节2019年中国家电行业产销分析

- 一、行业产成品情况总体分析
- 二、行业产品销售收入总体分析

第三节2019年年中国芯片设计行业财务指标总体分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章芯片设计行业赢利水平分析

第一节成本分析

- 一、2013-2019年芯片原材料价格走势
- 二、2013-2019年芯片设计行业人工成本分析

第二节产销运存分析

- 一、2013-2019年家电行业产销情况
- 二、2013-2019年家电行业库存情况
- 三、2013-2019年芯片设计行业资金周转情况

第三节盈利水平分析

- 一、2013-2019年芯片设计行业价格走势
- 二、2013-2019年芯片设计行业营业收入情况
- 三、2013-2019年芯片设计行业毛利率情况
- 四、2013-2019年芯片设计行业赢利能力
- 五、2013-2019年芯片设计行业赢利水平
- 六、2021-2027年芯片设计行业赢利预测

第十一章芯片设计行业盈利能力分析

第一节2019年中国芯片设计行业利润总额分析

- 一、利润总额分析
- 二、不同规模企业利润总额比较分析
- 三、不同所有制企业利润总额比较分析

第二节2019年中国芯片设计行业销售利润率

- 一、销售利润率分析
- 二、不同规模企业销售利润率比较分析
- 三、不同所有制企业销售利润率比较分析

第三节2019年中国芯片设计行业总资产利润率分析

- 一、总资产利润率分析
- 二、不同规模企业总资产利润率比较分析
- 三、不同所有制企业总资产利润率比较分析

第四节2019年中国芯片设计行业产值利税率分析

- 一、产值利税率分析

- 二、不同规模企业产值利税率比较分析
- 三、不同所有制企业产值利税率比较分析

第十二章世界典型芯片设计企业分析

第一节高通（qualcomm）

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

第二节博通（broadcom）

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

第三节nvidia

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

第四节新帝（sandisk）

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

第五节amd

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

力分析

- 四、公司投资风险

第十三章芯片设计优势企业分析

第一节上海华虹

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

第二节中星微电子

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

第三节中芯国际

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

第四节大唐微电子

- 一、企业概况
- 二、公司盈利能力分析
- 三、公司投资风险

第五节其他优势企业

- 一、士兰微电子
- 二、有研硅谷
- 三、上海蓝光
- 四、扬州华夏
- 五、深圳方大
- 六、大连路美
- 七、中国台湾信越
- 八、中国台湾威盛电子

第四部分投资策略与风险预警

第十四章芯片设计行业投资策略分析

第一节行业发展特征

- 一、行业的周期性
- 二、行业的区域性
- 三、行业的上下游
- 四、行业经营模式

第二节行业投资形势分析

- 一、行业发展格局
- 二、行业进入壁垒

三、行业swot分析

四、行业五力模型分析

第三节芯片设计行业投资效益分析

一、2019年芯片设计行业投资状况分析

二、2019年芯片设计行业投资效益分析

三、2021-2027年芯片设计行业投资方向

四、2021-2027年芯片设计行业投资建议

第四节芯片设计行业投资策略研究

一、2019年芯片设计行业投资策略

二、2021-2027年芯片设计行业投资策略

三、2021-2027年芯片设计细分行业投资策略

第十五章芯片设计行业投资风险预警

第一节影响芯片设计行业发展的主要因素

一、2019年影响芯片设计行业运行的有利因素

二、2019年影响芯片设计行业运行的稳定因素

三、2019年影响芯片设计行业运行的不利因素

四、2019年我国芯片设计行业发展面临的挑战

五、2019年我国芯片设计行业发展面临的机遇

第二节芯片设计行业投资风险预警

一、2021-2027年芯片设计行业市场风险预测

二、2021-2027年芯片设计行业政策风险预测

三、2021-2027年芯片设计行业经营风险预测

四、2021-2027年芯片设计行业技术风险预测

五、2021-2027年芯片设计行业竞争风险预测

六、2021-2027年芯片设计行业其他风险预测

第五部分发展趋势与规划建议

第十六章芯片设计行业发展趋势分析

第一节芯片设计研发趋势分析

一、芯片设计研究开发新趋势

二、芯片设计主要品种发展趋势

第二节芯片设计趋势分析

- 一、下一代手机功能设计趋势
- 二、下一代多媒体手机对差异化设计的要求
- 三、智能无线整合对芯片设计发展影响分析

第三节2021-2027年芯片设计行业规划建议

- 一、芯片设计行业“十三五”整体规划
- 二、芯片设计行业“十三五”发展预测

第十七章芯片设计企业管理策略建议

第一节市场策略分析

- 一、芯片设计价格策略分析
- 二、芯片设计渠道策略分析

第二节销售策略分析

- 一、媒介选择策略分析
- 二、产品定位策略分析
- 三、企业宣传策略分析

第三节提高芯片设计企业竞争力的策略

- 一、提高中国芯片设计企业核心竞争力的对策
- 二、芯片设计企业提升竞争力的主要方向
- 三、影响芯片设计企业核心竞争力的因素及提升途径
- 四、提高芯片设计企业竞争力的策略

第四节我国芯片设计品牌的战略思考

- 一、芯片设计实施品牌战略的意义
- 二、芯片设计企业品牌的现状分析
- 三、我国芯片设计企业的品牌战略
- 四、芯片设计品牌战略管理的策略

图表目录：

图表芯片设计产业的价值链

图表芯片设计产业与其他产业的关系

图表芯片设计产业链结构图

图表2013-2019年中国集成电路产业销售收入规模及增长

图表2019年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长

图表2019年中国集成电路产业各价值链结构

图表全球ic设计产业产值发展趋势

图表ic设计产业成长率优于全球ic产业成长率

图表2019年全球半导体电子设备设计国家排名

图表全球ic设计产业布局

图表全球ic设计产业概况

图表2019年中国台湾地区前十大设计公司

图表中国台湾地区历年前十大设计公司营收变化趋势

图表2013-2019年中国台湾主要无晶圆厂ic设计公司营收走势

图表2013-2019年中国台湾主要电源ic设计公司营收走势

图表2013-2019年间国内生产总值增长趋势

图表2013-2019年各季度国内生产总值走势

图表2013-2019年工业增加值及增长速度

图表2019年主要工业产品产量及其增长速度

图表2019年规模以上工业企业实现利润及其增长速度

图表2013-2019年固定资产投资增长情况

图表2013-2019年中国投资率和消费率变化情况

图表我国有线电视向数字化过渡时间表

图表低功率芯片技术实现

图表微笑曲线

图表2019年中国前十大ic设计业者排名

图表2013-2019年ic设计业销售收入

图表2013-2019年我国芯片设计业经济指标

图表我国ic设计业的swot分析

图表西部地区一些ic设计公司

图表2019年中国电源管理芯片市场品牌结构

图表dlp工作原理

图表使用dlp技术的厂商一览

图表lcos面板结构图

图表2019年我国主要宏观经济指标增长的市场预测

图表中国集成电路产业规模和增长速度

图表2021-2027年中国集成电路产业规模预测

图表2021-2027年中国集成电路产业链规模与增长预测

图表2013-2019年我国ic销售额预测

图表中国ic市场应用结构及自给能力

图表2013-2019年华虹集团经营动态

图表中芯国际技术文件的支持

图表2014年全球10大半导体供应商的初步排名

图表isuppli按公司总部所在地对全球半导体销售额进行的初步估计

图表软硬件协同设计流程

图表软硬件协同设计流程

图表设计人员正在使用电压岛、电源门控和其他功率控制技巧

图表2013-2019年我国集成电路芯片产量变动轨迹

图表2013-2019年集成电路及芯片产量变动轨迹

图表2019年中国市场nvidia与ati新品关注比例对比

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202109/237016.html>